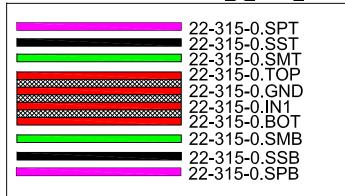


DRILL CHART					
SYM	DIAM	TOL	QTY	NOTE	
#	0.200 mm		188		
+	1.000 mm		22		
<b>♦</b>	1.100 mm		9		
ъ	3.500 mm		1		
×	3,500 mm		3	NON-PLATED	
TOTAL			223		

## PCB STACK-UP 4 LAYERS\_2\_SMD\_UP



## MATERIALE

TIPOLOGIA CIRCUITO	SUPPORTO	SPESSORE RAME
☐ MONOFACCIA	☐ FR2	X LATI ESTERNI 35u
☐ DOPPIA FACCIA	<b>X</b> FR4	LATI INTERNI
MULTISTRATO	□ ALTRO	SPESSORE SUPPORTO
N°LAYERS 4		1.6 mm

## TRATTAMENTI

RAME DI RIPORTO ELETTROLITICO MIN. 20u					
☐PLACC.ELETT. SURFUSO:	Sn/Pb 60/40-70/30 Sp.10-20u				
□PLACC.ELETT. RIFUSO S	Sn/Pb 60/40-70/30 Sp. 4-15u				
RAME PASSIVATO	MHOT AIR LEVELING				
□DORATURA(D=140±vPN)	0.3u0.6u1,0u1,3u2,0u				
□BISELLATURA	NUMERO DEI CONTATTI				
DEPOSITO DI GRAFITE	NUMERO DEI CONTATTI				

SOLDER RESIST	SERIGRAFIA
SERIGRAFICO Sp.	XLATO COMP.COLORE BIANCO
XFOTOGRAFICO Sp. 13−100u	XLATO SALD. COLORE BIANCO
COVER LAYERSp. 25-76u	

TABELLA DEI FORI CON LAVORAZ. PARTICOLARI				FILES DI DOCUMENTAZIONE ASSOCIATI PER LA LAVORAZIONE		
TIPO	ø MET.	ø N.MET.	Q.TA'	LAYER BOT	<b>▼</b> 22-315-0.BOT	
Α				LAYER TOP	<b>X</b> 22-315-0.TOP	
В				LAYER PWR		
С				LAYER GND	💢 22-315-0.GND	
D				SERIG. BOT	💢 22-315-0.SSB	
Е				SERIG. TOP	X 22-315-0.SST	
F				LAYER IN1	💢 22-315-0.IN1	
G				LAYER IN2		
Н				LAYER IN3		
I				LAYER IN4		
L				RESIST BOT	X 22-315-0.SMB	
М				RESIST TOP	💢 22-315-0.SMT	
NC	TE PAR	RTICOL	ARI	PAST BOT	X 22-315-0.SPB	
				PAST TOP	X 22-315-0.SPT	
				LAYER FOR.	X 22-315-0.DRL	
				DRILL CHART		
				DRILL TAPE	<b>▼</b> 22-315-0.TAP	
TUTTI I FORI NON INDICATI DEVONO				MECC.DRW.	💢 22-315-0.DWG	
ESSERE METALLIZATI						

A.3	MATERIALE	TRATTAMENTO	
1	VEDI TABELLA	VEDI TABELLA	
	TOLL.GENERALE	DISEGNATORE	
	±0.2		
T -	NOME FILE	REVISIONE	
	PF22-315-0.DWG	0	

	TRATTAMENTO VEDI TABELLA		METALTRONICA S.r.I.		
	DISEGNATORE	DATA 18/10/23	тітоьо PF 22—315—0		
.DWG	REVISIONE O	DATA	COD.INTERNO	SCALA F.S.	